

ニュースガイドNo, 11045

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中！ <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載！

貴金属メッキ方法と工程

[登録・公開編]平成27年(1年間) 70点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥21,600-	¥20,000-
全文紙収録 B5製本版	¥21,600-	¥20,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥32,400-	¥30,000-

既刊関連セットのご案内

No.	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,11021	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.26	68点	¥20,000
No,10875	"	"	平.25	67点	¥20,000
No,10817	"	"	平.24	69点	¥20,000
No,10702	"	"	平.23	69点	¥20,000
No,10567	"	"	平.22	70点	¥24,000
No,10429	"	"	平.21	72点	¥24,000
No,10293	"	"	平.20	78点	¥25,800
No,10157	"	"	平.19	88点	¥27,500
No,10047	"	"	平.18	89点	¥27,700
No,9920	"	"	平.17	84点	¥25,800
No,9787	"	"	平.16	87点	¥23,400
No,9642	"	"	平.15	76点	¥17,700
No,11002	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.26	70点	¥20,000
No,10891	"	"	平.25	70点	¥20,000
No,10830	"	"	平.24	70点	¥20,000
No,10700	"	"	平.23	59点	¥18,000
No,10579	"	"	平.22	59点	¥18,000
No,10493B	"	"	平.21	60点	¥18,000
No,10493A	"	"	平.20	60点	¥18,000

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com)

お電話でも承ります

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
所属部署名	題名	
	合計 ¥	
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所:〒		

料金には別途送料がかかります。

貴金属メッキ方法と工程

No.11045

[登録・公開編] 平成27年(1年間) 70点

CD-ROM版 ¥21,600 B5製本版 ¥21,600 (全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥32,400)

- | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|----|---|-----------------------------------|
| 1 | つや消し金属層の堆積のための電解質および方法 | エンソン インコーポレイテッド | 28 | プラチナおよびニッケル層の進歩的な附着によって表面をアルミナイズする方法 | スネクマ |
| 2 | 銅被覆ポリイミド基板の製造方法および電気めっき装置 | 住友金属鉱山株式会社 | 29 | めっき浴及びそれを用いためっき方法 | 株式会社大和化成研究所 |
| 3 | 複合めっき材料とそれを用いた電気・電子部品 | 古河電気工業株式会社 | 30 | 把持具の把持面のめっき処理方法及び把持具 | ジャスト株式会社 |
| 4 | 封孔処理剤溶液及びそれを用いた封孔処理方法 | 株式会社大和化成研究所 | 31 | 金めっき装飾品、模擬刀及びその金めっき方法 | 名古屋メッキ工業株式会社 |
| 5 | 銀めっき材およびその製造方法 | DOWAメタルテック株式会社 | 32 | 金属めっきされたTi材の製造方法および多孔質電極の製造方法 | 三菱電機株式会社 |
| 6 | 耐食導電被覆材料の製造方法 | カーリットホールディングス株式会社 | 33 | めっき材の製造方法及びめっき材 | オリエンタル鍍金株式会社 |
| 7 | 電気接点材料及びその製造方法 | 古河電気工業株式会社 | 34 | 電磁波シールド用金属箔、電磁波シールド材及びシールドケーブル | JX日鉱日石金属株式会社 |
| 8 | めっき部材およびその製造方法 | DOWAメタルテック株式会社 | 35 | 電磁波シールド用金属箔、電磁波シールド材、及びシールドケーブル | JX日鉱日石金属株式会社 |
| 9 | シアン系金 - パラジウム合金めっき液及びめっき方法 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 | 36 | めっき部材、コネクタ用めっき端子、めっき部材の製造方法、およびコネクタ用めっき端子の製造方法 | 株式会社オートネットワーク技術研究所 |
| 10 | チタン基材への貴金属めっき方法及び固体高分子型燃料電池用セパレータ | トヨタ自動車株式会社 | 37 | めっき材の製造方法及びめっき材 | オリエンタル鍍金株式会社 |
| 11 | 電着金ナノ構造 | ロイヤル・メルボルン・インスティテュート・オブ・テクノロジー | 38 | 銀 - 錫合金めっき層を含む金属積層体の製造方法 | オリエンタル鍍金株式会社 |
| 12 | 固体電解質膜を用いた金属膜形成方法 | トヨタ自動車株式会社 | 39 | 金 - 鉄系アモルファス合金めっき薄膜の成膜方法、電気めっき液、及び金 - 鉄系アモルファス合金めっき薄膜 | 学校法人早稲田大学 |
| 13 | スーパーキャパシタ用ナノ多孔性電極及びこれの製造方法 | ソングングワン ユニバーシティ ファウンデーションフォー コーポレート コ... | 40 | めっき浴および方法 | ローム アンド ハース エレクトロニック マテリアルズエルエルシー |
| 14 | コネクタ | 日本モレックス合同会社 | 41 | 電解金めっき液及びそれを用いて得られた金皮膜 | 日本高純度化学株式会社 |
| 15 | リチウムイオン二次電池用電解銅箔とその製造方法 | 古河電気工業株式会社 | 42 | 銀めっき材およびその製造方法 | DOWAメタルテック株式会社 |
| 16 | 金めっき液 | ローム・アンド・ハース電子材料株式会社 | 43 | 可動接点部品用材料およびその製造方法 | 古河電気工業株式会社 |
| 17 | アンダーポテンシャル析出で媒介される薄膜の逐次積層成長 | ブルックハイヴン サイエンス アソシエイツ, エルエルシー | 44 | 発光装置用リードフレーム又は基板に用いられるめっき液、並びに、それを用いて製造されるリードフレー... | 日亜化学工業株式会社 |
| 18 | 銀めっき材およびその製造方法 | DOWAメタルテック株式会社 | 45 | 接続タブ及びこれを用いた太陽電池モジュール | 株式会社マイティ |
| 19 | 可動接点部品用被覆複合材および可動接点部品、スイッチならびにその製造方法 | 古河電気工業株式会社 | 46 | チップ電子部品の製造方法 | サムソン エレクトロ - メカニックス カンパニーリミテッド. |
| 20 | ノンシアン系金 パラジウム合金めっき液及びめっき方法 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 | 47 | 電気接点用貴金属被覆材およびその製造方法 | 古河電気工業株式会社 |
| 21 | リードフレーム | 株式会社三井ハイテック | 48 | レジストパターンの製造方法、配線パターンの製造方法及び配線基板 | 日立化成株式会社 |
| 22 | 抗置換硬質金組成物 | ローム アンド ハース エレクトロニック マテリアルズエルエルシー | 49 | フィルターおよびその製造方法 | 大日本印刷株式会社 |
| 23 | 電磁波シールド用金属箔、電磁波シールド材及びシールドケーブル | JX日鉱日石金属株式会社 | 50 | Ag - Sbめっき膜を有する電子部品、Ag - Sbめっき液及び前記電子部品の製造方法 | JX日鉱日石金属株式会社 |
| 24 | コネクタ用めっき端子 | 株式会社オートネットワーク技術研究所 | 51 | 金めっき用ノンシアン金塩の製造方法 | 小島化学薬品株式会社 |
| 25 | 金めっき用ノンシアン金塩の新規製造方法 | 小島化学薬品株式会社 | 52 | 黒色合金メッキ皮膜 | 共栄メタル株式会社 |
| 26 | 金めっき用ノンシアン金塩の新規製造方法 | 小島化学薬品株式会社 | 53 | シアン化物非含有酸性つや消し銀電気めっき組成物および方法 | ローム アンド ハース エレクトロニック マテリアルズエルエルシー |
| 27 | 金属部品および金属部品の製造方法 | 株式会社ニステック | 54 | コネクタ | 日本モレックス合同会社 |

以下16点省略